

## 智微科技 USB3.1 to PCIe 橋接晶片取得 USB 協會認證

USB 及 Type-C 高速橋接 IC 設計公司—智微科技(GTSM: 4925)宣布其業界首顆內嵌 PCIe/NvMe 技術的新一代超高速 USB 橋接晶片：JMS583, USB3.1 Gen2 to PCIe/NvMe，於 6 月在美國波特蘭(俄勒岡州)舉辦的年度 USB 相容性測試大會(USB-IF Compliance Workshop)中，通過各項規格測試並成功取得認證 ( TID : 5,040,109,048 )。

JMS583 是將 PCIe/NVMe 裝置轉接成 USB 介面的一款橋接晶片，內嵌智微自行開發的 USB/NVMe 資料互轉技術，能將外接存儲裝置的實際資料傳輸速率提升至 1000MB/s 以上，是業界首顆能達到 USB 3.1 10Gbps 傳輸頻寬極限的晶片。此外，JMS583 內嵌 USB Type-C™ 的控制線路，可支援方便的 USB 正反插功能，並優化晶片內部電源管理的控制程序，能有效簡化客戶端產品設計驗證流程，縮短產品上市前的設計驗證週期。

JMS583 橋接晶片主要應用於 PCIe/NVMe 技術開發出的產品，可將之轉換成 USB 介面成為高速隨身移動裝置；應用產品種類除了連接搭載 PCIe 介面的固態硬碟(SSD)成為高速外接 SSD 應用方案外，亦能連接的新一代 CF Express 與 SD Express 高速記憶卡成為高速讀卡器或是高速隨身碟。

JMS583 橋接晶片已於今年四月進入量產，現已有多家品牌廠商相繼投入開發或量產出貨；此外，JMS583 亦同步和市場主流的 SSD 主控晶片廠商完成合作開發對應的 PCIe/NVMe 生產使用的晶片燒錄流程，此一新的程序可大幅縮減 SSD 模組廠在量產 PCIe SSD 時的成本與時間，進而加速終端客戶的產品上市時程。智微認為，市場對於外接存儲產品必須具備高速、省電、輕薄等特色的需求趨

勢不變，因此，於今年第三季起，加入開發應用 JMS583 橋接晶片的客戶及廠商，將會有可期待的成長比率。